

2023 年 12 月 6 日

プレスリリース

リガク・ホールディングス株式会社  
株式会社リガク

## リガク、SEMICON Japan 2023 に出展 ～ 半導体製造の品質管理を支える最先端のX線分析装置を紹介 ～

リガク・ホールディングスのグループ会社である、X線分析装置における世界的ソリューションパートナーの株式会社リガク(本社:東京都昭島市 代表取締役社長:川上 潤、以下「当社」)は、2023 年 12 月 13 日から 15 日まで東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2023」に出展します。

SEMICON Japan は、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、自動車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。



リガク 展示ブースイメージ

当社は、高品質な半導体製造のために欠かすことのできない、X線を用いた多様な測定・分析装置を提供しています。今回の出展では DX(Digital Transformation)における、頭脳「先端デバイス」、心臓「パワーデバイス」、五感「IoT:MEMS・センサー・RF デバイス」の3つのコーナーを設けました。半導体製造の工程・目的・形状に応じて、高精度な分析を短時間で実現する製品ラインナップの特徴や、実際の測定例をご紹介します。

世界的需要がますます高まる半導体の R&D から品質管理までを支える、リガクの最先端 X 線技術をご覧ください。

### 【展示の見どころ】

DX 社会の実現に向けて、高速化、高密度化、省エネ化等の各種半導体の新しい計測・検査ニーズに応えるソリューションを提供します。

- 詳細は特設ページをご参照下さい。<https://japan.rigaku.com/event/semicon2023/>

### 【SEMICON Japan 2023 出展概要】

- イベント名称: SEMICON Japan 2023 (<https://www.semiconjapan.org/jp>)
- 期間: 2023 年 12 月 13 日(水)~15 日(金) 10:00-17:00
- 場所: 東京ビッグサイト
- ブース番号: Hall4 : 4427
- 出展内容: 「先端デバイス」「パワーデバイス」「IoT: MEMS・センサー・RF デバイス」の 3 つのコーナーで装置の特徴と測定事例を紹介

### 【リガクグループについて】

リガクグループは、X線分析技術をコアに熱分析技術等も含めた最先端の分析技術で社会をけん引する技術者集団です。世界 90 か国以上で産業・研究用分析のグローバルソリューションパートナーとしてお客様と共に発展と成長を続け、日本国内で極めて高いシェアを誇るうえ、海外売上比率は約 70% に達しています。応用分野は、半導体や電子材料、電池、環境・資源・エネルギーからライフサイエンスに至るまで日々拡大しています。9 か国の拠点、約 2,000 名の従業員が 1951 年の創業以来 70 年以上にわたり「見るチカラで、世界を変える」イノベーションの実現に取り組んでいます。

詳しくは [japan.rigaku.com/ja](http://japan.rigaku.com/ja) をご覧ください。(2023 年 11 月末現在)

#### 【リリースに関するお問い合わせ先】

リガク・ホールディングス株式会社 コミュニケーション部

部長 姫野 佐和

TEL: 090-6331-9843 e-mail: [prad@rigaku.co.jp](mailto:prad@rigaku.co.jp)